

文章编号:1004-2174(2013)03-0438-03

功率参数对光电薄膜 Mg₂Si 择优取向的影响

余志强¹, 谢 泉²

(1. 湖北民族学院 电气工程系, 湖北 恩施 445000; 2. 贵州大学 理学院, 贵州 贵阳 550025)

摘要:采用射频磁控溅射设备,在硅(111)衬底上制备了光电半导体薄膜 Mg₂Si。通过 X 线衍射仪(XRD)和场致发射扫描电子显微镜(FESEM)对 Mg₂Si 的晶体结构和微观形貌进行了表征,研究了功率参数对光电半导体薄膜 Mg₂Si 外延择优取向的影响。结果表明,在 60~90 W 的溅射功率范围内,硅基外延 Mg₂Si 具有 Mg₂Si(220)的外延择优生长特性,且随着溅射功率的增加 Mg₂Si(220)晶面的衍射峰强度先增大后减小,在 70 W 溅射功率下 Mg₂Si(220)晶面的衍射峰强度最强。

关键词:射频磁控溅射; 硅化二镁; 功率参数; 择优取向

中图分类号:O484.1 文献标识码:A

Effects of Sputtering Power on Preferred Orientation of Semiconductor Optoelectronics Mg₂Si Films

YU Zhiqiang¹, XIE Quan²

(1. Dept. of Electrical Engineering, Hubei University for Nationalities, Enshi 445000, China;

2. College of Science, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract: The epitaxial films of semiconductor optoelectronics Mg₂Si are prepared on Si (111) substrates by radio frequency magnetron sputtering. The crystal structures and the micro topography of Mg₂Si films are characterized by X-ray diffraction and field emission scanning electron microscope. The effects of sputtering power on preferred orientation of Mg₂Si films on Si(111) substrates are obtained. The results show that the Mg₂Si films with one preferential growth Mg₂Si(220) increases firstly with increasing sputtering power from 60 W to 90 W, then decreases after reaching a maximum and the sputtering power is 70 W.

Key words: radio frequency magnetron sputtering; Mg₂Si; sputtering power; preferred orientation

0 引言

作为一种新型的环境半导体材料^[1-2], 半导体 Mg₂Si 由资源寿命极长的硅、镁元素组成, 它对地球无污染, 能循环利用, 因此越来越受到人们的青睐。Mg₂Si 是硅、镁二元化合物中唯一稳定存在的化合物^[3], 其能隙^[4]窄, 热电势率高和热导率低, 是一种很有发展潜力的热电半导体材料^[5]。Mg₂Si 与传统的硅工艺兼容, 可在硅衬底上外延^[6]生长, 在半导体工业具有重要的应用前景。

目前在国际上, 对于半导体 Mg₂Si 的实验研究相对较少, 这主要是由于 Mg 具有高的蒸汽压^[7]和低的凝结系数, 使半导体 Mg₂Si 制备难。已报道的主要有通过分子束外延^[8-9]、离子束注入^[10-12]和脉冲激光^[11]等进行半导体薄膜 Mg₂Si 的制备, 而采用射频磁控溅射设备进行硅基外延半导体薄膜 Mg₂Si 的制备却未见报道。

本文采用射频磁控溅射设备, 在硅(111)衬底上制备了半导体薄膜 Mg₂Si。通过 X 线衍射仪(XRD)分析了硅基外延半导体薄膜 Mg₂Si 的晶体结构, 通过场致发射扫描电子显微镜(FESEM)分析了硅基外延半导体薄膜 Mg₂Si 的微观形貌, 研究了功率参数对硅基外延半导体薄膜 Mg₂Si 择优取向的影响。研究结果为光电半导体薄膜 Mg₂Si 的工业化应用提供了实验基础。

1 实验

1.1 样品制备

采用硅 Si(111)片作为进行射频磁控溅射的衬底基片, 进行尺寸为 5 mm×5 mm。将硅基片通过无水酒精、丙酮超声波振荡清洗, 然后用去离子水超声波振荡清洗干净。将衬底硅基片放入磁控溅射仪的样品室中反溅 15 min, 以便除去衬底硅基片表面的杂质, 增加衬底硅基片表面的微观粗糙度, 有利于

收稿日期:2012-07-01

基金项目:湖北省教育厅自然科学基金资助项目(B20122903); 湖北省科技厅科学研究基金资助项目(2010CDB00901)

作者简介:余志强(1984-),男,湖北黄冈人,讲师,硕士,主要从事电子功能材料及器件的研究。E-mail: y_zq2008@yahoo.cn

增加薄膜在溅射沉积时的附着力。

进行射频磁控溅射的过程中,射频溅射所用的镁靶纯度为99.99%,磁控溅射仪溅射室的本底真空为 1.2×10^{-5} Pa,工作气压为5 Pa,射频溅射功率范围为60~90 W,氩气流量为15 mL/min。对于Si(111)衬底基片,通过射频磁控溅射仪在室温条件下射频溅射沉积镁膜10 min,然后将溅射好的镁膜样品装入钼盒,在优化的热处理条件下置于石英管高真空退火炉中进行二次退火。

1.2 表征

采用日本理学D/max 2200PC型XRD分析Mg₂Si样品的晶体结构,CuK α 辐射。通过日本日立S-4800型FESEM观察Mg₂Si样品的微观形貌。

2 结果及分析

2.1 功率参数对光电薄膜Mg₂Si结构的影响

图1为在不同射频磁控溅射功率下制备的薄膜样品的XRD谱。由图可知,在不同射频溅射功率条件下制备的各薄膜样品的晶相均为半导体Mg₂Si。在60~90 W的射频溅射功率范围内,硅基外延半导体薄膜Mg₂Si具有Mg₂Si(220)的外延择优生长特性,且随着溅射功率的增加,样品中Mg₂Si相位于40.2°处晶面的特征主衍射峰强度先逐渐增强,而后逐渐减弱。当溅射功率达到70 W时,Mg₂Si的特征主衍射峰强度最强,制备的半导体薄膜Mg₂Si样品的主要衍射晶面分别包括(111)、(200)、(220)、(311)和(400),与光电半导体薄膜Mg₂Si的标准谱^[13] PDF # 65-9365卡片(晶格常数 $a=b=c=0.635$ nm)基本吻合。当继续增加溅射功率时,发现半导体薄膜Mg₂Si的特征主衍射峰强度又逐渐减弱,表明功率参数对硅基光电半导体薄膜Mg₂Si的外延择优取向具有重要的影响。

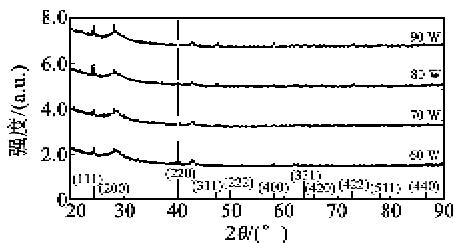


图1 不同磁控溅射功率下样品的XRD谱

2.2 功率参数对光电薄膜Mg₂Si晶格的影响

表1为不同溅射功率条件下二次退火样品的晶格常数,其中晶格常数根据布喇格方程^[14]计算得到。由表可知,在不同溅射功率下制备的各样品的晶相均为半导体Mg₂Si,各样品的晶格常数与Mg₂Si标准晶格常数相接近。图2为在不同溅射功率下制备的Mg₂Si样品的晶格常数变化曲线图。

根据布喇格方程可计算得到Mg₂Si样品晶格常数

$$d = n\lambda / (2 \sin \theta) \quad (1)$$

式中: θ 为入射X线与相应晶面的夹角; λ 为X线的波长; n 为衍射级数。布喇格方程是晶体衍射的理论基础。

表1 不同溅射功率下样品Mg₂Si(220)晶面的晶格常数

溅射功率/W	标准晶格常数/nm	样品Mg ₂ Si(220)晶面	
		λ /nm	d/nm
60	0.635	0.154	0.658
70	0.635	0.154	0.736
80	0.635	0.154	0.699
90	0.635	0.154	0.689

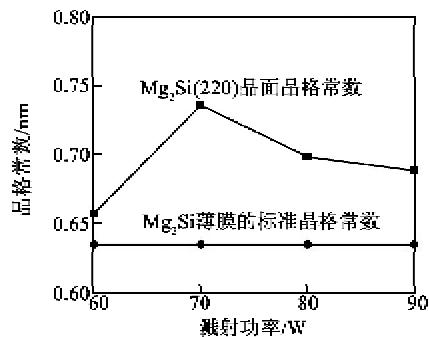


图2 不同溅射功率下样品的晶格常数变化曲线

2.3 功率参数对光电薄膜Mg₂Si微观形貌的影响

图3为在70 W溅射功率下制备的半导体Mg₂Si样品的FESEM图。由图可见,在70 W溅射功率条件下制备的样品晶体表面细密紧凑,结晶度良好,这与图1分析一致。由此可知,功率参数对硅基光电半导体薄膜Mg₂Si的外延择优取向具有重要的影响。

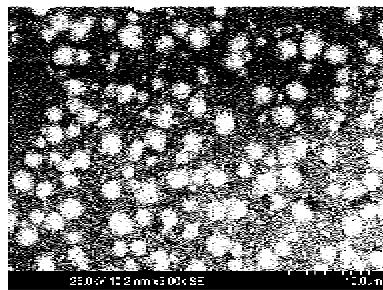


图3 70 W溅射功率下样品的表面形貌FESEM照片

3 结束语

采用射频磁控溅射技术在Si(111)衬底上制备了不同溅射功率下的Mg₂Si外延半导体薄膜。通过X线衍射仪和场致发射扫描电子显微镜对Si基外延半导体薄膜Mg₂Si的晶体结构和表面形貌进行了表征,分析了功率参数对半导体薄膜Mg₂Si外

延取向的影响。研究结果表明,功率参数对于Si基光电半导体薄膜Mg₂Si的晶格常数具有重要影响,当溅射功率达到70 W时,通过一定的热处理工艺可得到理想的硅基光电半导体薄膜Mg₂Si。

参考文献:

- [1] BALEVA M, ZLATEVA G, ATANASSOV A, et al. Resonant Raman scattering in ion-beam-synthesized Mg₂Si in a silicon matrix[J]. Phys Rev B, 2005, 72: 115330.
- [2] ATANASSOV A, BALEVA M. On the band diagram of Mg₂Si/Si heterojunction as deduced from optical constant dispersions[J]. Thin Solid Films, 2007, 515: 3046-3051.
- [3] ROBERTS G A, CAIRNS E J, REIMER J A. Magnesium silicide as a negative electrode material for lithium-ion batteries[J]. J Power Sources, 2002, 110: 424-429.
- [4] MORRIS R G, REDIN R D, DANIELSON G C. Semiconducting properties of Mg₂Si single crystals [J]. Phys Rev, 1958, 109: 1909-1915.
- [5] TANI J, KIDO H. Thermoelectric properties of Bi-doped Mg₂Si semiconductors[J]. Physica B, 2005, 364: 218-224.
- [6] 余志强, 谢泉, 肖清泉, 等. Mg₂Si晶体结构及消光特性的研究[J]. 物理学报, 2009, 58(10): 6889-6893.
YU Zhiqiang, XIE Quan, XIAO Qingquan, et al. Structure and extinction properties of Mg₂Si crystal [J]. Acta Phys Sin, 2009, 58(10): 6889-6893.
- [7] VANTOMME A, LANGOUCHE G, MAHAN J E, et al. Growth mechanism and optical properties of semiconducting Mg₂Si thin films[J]. Microelectronic Engineering, 2000, 50(1/4): 237-242.
- [8] MAHAN J E, VANTOMME A, LANGOUCHE G, et al. Semiconducting Mg₂Si thin films prepared by molecular-beam epitaxy[J]. Phys Rev B, 1996, 54(23): 16965-16971.
- [9] VANTOMME A, MAHAN J E, LANGOUCHE G, et al. Thin film growth of semiconducting Mg₂Si by codeposition[J]. Appl Phys Lett, 1997, 70: 1086-1088.
- [10] SERIKAWA T, HENMI M, KONDOH K. Microstructure and Mg concentration of Mg-Si thin film deposited by ion beam sputtering on glass substrate[J]. J Vac Sci Technol A, 2004, 22: 1971-1974.
- [11] SONG S W, STRIEBEL K A, SONG X Y, et al. Amorphous and nanocrystalline Mg₂Si thin-film electrodes[J]. J Power Sources, 2003(119/121): 110-112.
- [12] GORANOVA E, AMOV B, BALEVA M, et al. Ion beam synthesis of Mg₂Si[J]. J Mater Sci, 2004, 39: 1857-1859.
- [13] BARLOCK J G, MONDOLFO L F. Structure of some Al-Fe-Mn-Si alloys[J]. Z Metallkd, 1975, 66: 605-611.
- [14] SCHERRER P. Nachrichten von der gesellschaft der wissenschaften zu goettingen[J]. Mathematisch-physikalische Klasse, 1918, 2: 98-100.

(上接第437页)

- [8] WU Yunyi, WANG Xiaohui, ZHONG Caifu, et al. Effect of anneal conditions on electrical properties of Mn-doped (Na_{0.85}K_{0.15})_{0.5}Bi_{0.5}TiO₃ thin films prepared by Sol-Gel method[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94(6): 1843-1849.
- [9] ZHONG Caifu, WANG Xiaohui, LI Longtu, et al. Fabrication and properties of epitaxial growth BiScO₃-PbTiO₃ thin film via a hydrothermal method[J]. Applied Physics Letters, 2008, 92(22): 1-3.
- [10] CHEN Xiaoming, LIAO Yunwen, WANG Huaiping, et al. Phase structure and electric properties of Bi_{0.5}(Na_{0.82}K_{0.175})_{0.5}TiO₃ ceramics prepared by a Sol-Gel method[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2009, 493(1/2): 368-371.
- [11] GONG Wen, LI Jingfeng, CHU Xiangcheng, et al. Preparation and characterization of Sol-Gel derived (100)-textured Pb(Zr,Ti)O₃ thin films: PbO seeding role in the formation of preferential orientation[J]. Acta Materialia, 2004, 52(9): 2787-2793.
- [12] 林贤福. 现代波普分析法[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2009.
- [13] SILVERSTEIN R M, WEBSTER F X, KIEMLE D J. 有机化合物波谱分析[M]. 药明康德新药开发有限公司分析部, 译. 上海: 华东理工大学出版社, 2007.
- [14] PARK Y I, KIM C E, LEE H W. Effects of catalyst and solvent on PbTiO₃ fibers prepared from triethanolamine complexed titanium isopropoxide[J]. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1999, 14(2): 149-162.
- [15] KIM C E, PARK Y I, LEE H W. Preparation of Pb-TiO₃ fibers using triethanolamine-complexed alkoxide [J]. Journal of Materials Science Letters, 1997, 16(2): 96-100.
- [16] KITAOKA K, TAKAHARA K, KOZUKA H, et al. Sol-Gel processing of transparent PLZT ((Pb, La)(Zr, Ti)O₃) fibers[J]. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1999, 16(1/2): 183-193.